附表

附圖一（系爭商標圖樣）
申請人：日月光半導體製造股份有限公司 商品名稱：半導體晶圓蝕刻加工處理、半導體封裝處理等；半導體相關產品技術之研究發展（替他人）、半導體封裝設計等。 商標圖樣： aMAPPoP